

2026 年 10 月 8 日
TOPPAN 株式会社

TOPPAN、Rapidus がグローバルなエコシステムの 枠組みとして構築する「Rapidus CORE」に参画

最先端半導体の Design Solution Associate として、
LSI 設計・開発エコシステムの構築に貢献

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:野口 晴彦、以下 TOPPAN)はこのたび、Rapidus 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO:小池 淳義、以下 Rapidus)が、最先端半導体の開発・量産を支えるグローバルなエコシステムの枠組みとして構築する「Rapidus CORE(Rapidus Collaborative Open Rapid Ecosystem、以下 Rapidus CORE)」に、Design Solution Associate として参画します。

■ 背景と狙い

近年、AI の急速な普及や高性能コンピューティング、自動運転技術などの進展に伴い、演算能力の大幅な向上と高い省電力性を両立する最先端ロジック半導体の需要が世界的に急増しています。これに伴い、半導体プロセスは 2nm 世代をはじめとする次世代ノードへと移行しつつあります。一方で、半導体プロセスの微細化・極小化が進むにつれ、LSI(大規模集積回路)の設計は極めて複雑化しています。製造リスクの増大に伴う設計のやり直しや検証負荷の増大は、製品開発コストの急増や開発サイクルの長期化を引き起こしており、設計から製造までを円滑に結ぶ高度な設計ソリューションの提供と、オープンな協調体制の構築が課題となっています。

Rapidus は設計から前工程・後工程に至る半導体バリューチェーン全体でイノベーションを推進し、従来のサプライチェーンの枠組みを超えたパートナー主導の新たな価値創出と、次世代 LSI 開発のスピードアップを目指し、このたびグローバルなエコシステムの枠組みである「Rapidus CORE」を立ち上げました。

また「Rapidus Core」の第一弾として、今回 TOPPAN が参画する設計関連企業群である Design Solution Associate があわせて発表されました。Design Solution Associate は、顧客と Rapidus をつなぎ、各社の設計リソースや専門知見を提供し、半導体開発の迅速な立ち上げの支援をします。これにより、顧客ニーズに応じた設計から製造までの支援体制強化が可能となります。

TOPPAN は、長年に渡り培ってきた LSI 設計技術、EDA(設計自動化)環境の最適化ノウハウを強力な強みとしています。特に、近年の微細化が進む先端プロセスノードにおける低消費電力(Low Power)設計、PVT(Process/プロセス、Voltage/電圧、Temperature/温度)変動によるタイミング収束、高速インタフェースの導入など、設計難易度の高いソリューションの知見も保有しています。

今回、「Rapidus CORE」の Design Solution Associate として参画することで、Rapidus の顧客の仕様検討から、回路設計、レイアウト、物理検証に至るまでをトータルでサポートします。最先端プロセス特有の設計難易度やコスト・リスクを大幅に低減し、持続可能なエコシステムの構築に貢献します。

■ 今後の目標

TOPPAN は、「Rapidus CORE」への参画を通じて、次世代半導体の持続可能なエコシステムの構築に寄与するとともに、最先端半導体技術を活用した社会課題の解決と新たな価値創出に貢献します。

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上